

番号	連絡先氏名	勤務先	発表題目 和文
1 [1] 接合信頼性	河村 祐貴	三菱電機株式会社	繰返し通電試験における接合部の寿命を簡易に予測する手法
2 [1] 接合信頼性	岩本 博之	千住金属工業株式会社	Periodic Reverse電流法による外部応力型スズウィスカ抑制の検討
3 [1] 接合信頼性	田中 裕大	鹿児島大学	有機エレクトロニクス用印刷Ag配線の含掌曲げ疲労評価
4 [1] 接合信頼性	伊勢谷 健司	(株)先端力学シミュレーション研究所	パワーモジュール実装信頼性に対する封止樹脂物性の影響
5 [1] 接合信頼性	師岡 弘一	芝浦工業大学大学院	使用中の組織粗大化による強度低下を組み込んだ熱および振動複合負荷におけるBGAはんだ接合部の疲労寿命予測
6 [2] 次世代パッケージ	大井 淳	新光電気工業株式会社	有機インターポーザと低温はんだ接合
7 [2] 次世代パッケージ	中村 雄三	三井化学株式会社	チップオンウェア(CoW)ハイブリッド接合のための薄膜接着材料
8 [2] 次世代パッケージ	大野 堅太	芝浦工業大学大学院	半導体実装構造における再配線用絶縁層の破壊解析
9 [2] 次世代パッケージ	堀部 晃啓	日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所	アンダーフィル圧力注入装置に関する技術検討
10 [3] パワーデバイス1	藪田 康平	三菱電機株式会社	Agシンター接合における接合層形成過程のモニタリング手法の検討
11 [3] パワーデバイス1	酒 金亨	千住金属工業株式会社	低温無加圧で無垢銅基板と直接接合できる新規Agペースト
12 [3] パワーデバイス1	小杉 祥	三菱電機株式会社 先端技術総合研究所	樹脂コーティングによるパワーモジュールの高信頼性化に関する検討
13 [3] パワーデバイス1	北嶋 征	鹿児島大学	死荷重試験によるパワーモジュール用Alワイヤのクリープ特性評価
14 [3] パワーデバイス1	浦地 剛史	三菱電機株式会社 コンポーネント製造技術センター	Al合金ワイヤ適用によるパワーモジュールのパワーサイクル寿命の向上
15 [4] パワーデバイス2	杉本 大成	芝浦工業大学大学院	ダイアタッチ接合部における疲労き裂ネットワーク破壊寿命予測の検討
16 [4] パワーデバイス2	大崎 潤二	芝浦工業大学大学院	破壊力学的アプローチにより求めたAgナノ粒子焼結体の疲労特性
17 [4] パワーデバイス2	弓場 敦司	鹿児島大学	パワーデバイス用高温鉛はんだの微視的構造と強度の関係
18 [4] パワーデバイス2	伊藤 直樹	大阪大学大学院	異方性導電シートによる接合体の熱伝導率と応力緩和特性
19 [5] MEMS、医療センサ	董 佳速	鳥取大学	手術支援ロボット用鉗子のための把持力計測の検討
20 [5] MEMS、医療センサ	高橋 誠	大阪大学	導通部と絶縁部が共存するガラス同士の陽極接合界面の作成
21 [5] MEMS、医療センサ	山田悠太郎	法政大学 理工学部 電気電子工学科	酸化亜鉛ナノ粒子を電子注入層として用いた液体有機ELの特性評価
22 [5] MEMS、医療センサ	坂口 諒	国立大学法人電気通信大学 新竹研究室	マイクロソフトポンプに向けた電極作製法の検証
23 [5] MEMS、医療センサ	松前貴司	産業技術総合研究所 デバイス技術研究部門	ダイヤモンド/異種材料の大気中低温直接接合
24 [6] 有機/無機(接合)1	長岡 崇	大成プラスチック株式会社	射出接合による金属/樹脂接合体に対する非破壊分析の検討
25 [6] 有機/無機(接合)1	山田 由香	大阪大学大学院工学研究科	C-H-Si膜を介した銅/樹脂接合体の接合強度に及ぼす膜形成状態の影響
26 [6] 有機/無機(接合)1	常 昊	東京大学生産技術研究所 機械・生体系部門	陽極酸化アルミニウムと樹脂の成形接合における樹脂充填の分析
27 [6] 有機/無機(接合)1	日野実	広島工業大学工学部機械システム工学科	アルミニウム合金-樹脂異材接合に及ぼすレーザー照射の影響
28 [6] 有機/無機(接合)1	辻直生	大阪大学	コールドスプレー法を用いた基板表面の凸型形状形成による樹脂/金属界面強度への影響
29 [7] 有機/無機(接合)2	中島 伸一郎	日本航空電子工業㈱	フレキシブルハイブリッドエレクトロニクスを志向した電気接続のための加工技術
30 [7] 有機/無機(接合)2	高橋 雄太	鹿児島大学	パワーデバイス中の封止樹脂-金属基板界面における低サイクル疲労き裂進展挙動
31 [7] 有機/無機(接合)2	後藤 綾介	日本アピオニクス株式会社 電子機器事業部	金属と樹脂の直接接合における接合強度の評価
32 [7] 有機/無機(接合)2	三ツ木寛尚	群馬大学理工学系技術部機械センター部門	ビスフェノールF型エポキシ樹脂/はんだ接着界面の強度評価
33 [7] 有機/無機(接合)2	桑野 亮一	広島工業大学 機械システム工学科	ポリアミド樹脂とA5052アルミニウム合金の異種材料接合における低電力駆動の大気圧プラズマジェットによる表面処理の効果
34 [8] 有機/無機(材料)	井上 雅博	群馬大学	導電性接着剤中のフィラー間界面コンタクト発達に及ぼすバインダケミストリの影響
35 [8] 有機/無機(材料)	齋藤 優樹	群馬大学	カルボン酸系表面処理剤による鉛被覆アルミニウムフィラー含有導電性接着剤の電気伝導特性制御
36 [8] 有機/無機(材料)	木村 裕子	富士高分子工業株式会社	熱伝導性複合材料の接触熱抵抗値に影響を及ぼす因子の研究
37 [8] 有機/無機(材料)	中島 太聖	鹿児島大学	有機薄膜トランジスタの曲げおよび面外圧縮負荷による電気特性変動
38 [8] 有機/無機(材料)	横峯樹	サンクレック株式会社 半導体事業部	低誘電特性を持つ液状封止材料の開発
39 [9] プリントابلエレクトロニクス	中村 友洋	大阪大学	Agペースト配線の電気抵抗に対するアンペア級通電の影響
40 [9] プリントابلエレクトロニクス	大塚 海翔	群馬大学	ポリウレタン基板上に印刷形成したストレッチャブルPEDOT : PSS配線の電気伝導特性の評価
41 [9] プリントابلエレクトロニクス	西村 和也	大阪大学	透明フレキシブル電気化学トランジスタの印刷製膜と周波数特性の評価
42 [9] プリントابلエレクトロニクス	荒木 徹平	大阪大学	超柔軟な透明配線技術の開発と高耐久エレクトロニクスへの応用
43 [9] プリントابلエレクトロニクス	井上 雅博	群馬大学	銀フィラーを用いた導電性ペーストによるストレッチャブル印刷配線の電気的および機械的挙動に及ぼすフィラー形状の影響
44 [10] システム化・設計	日比野 浩典	東京理科大学	スマート生産システムが考慮すべき環境とシミュレーション技術の動向
45 [10] システム化・設計	森永 英二	大阪府立大学	混流生産における投入順序付けと部品搬送計画の統合化
46 [10] システム化・設計	若松 栄史	大阪大学大学院	線状/薄板状物体とその構造体の変形シミュレーション
47 [10] システム化・設計	峯田 龍志	大阪大学大学院工学研究科	機械学習を用いた高速近似解析手法構築における能動学習による効率化に関する研究
48 [10] システム化・設計	石原 佑真	大阪大学大学院 工学研究科	航空機用ワイヤーハーネス結束工具のための型の設計
49 [10] システム化・設計	多田 剛志	大阪大学 大学院	動作パラメータを利用した接合部の温度制御によるロボットソルダリング
50 [10] システム化・設計	海老名 将弥	大阪大学大学院工学研究科 マテリアル生産科学専攻	無加圧特性フィルタを用いたソルダリング接合部のニューラルネットワーク視覚検査
51 [11] ナノ・マイクロマテリアル	三並 淳一郎	株式会社大阪ソーダ	無加圧プロセスによる銀焼結型ダイアタッチ材の開発とその評価
52 [11] ナノ・マイクロマテリアル	前出 正人	パナソニック株式会社	軟磁性合金薄帯の粉体化による高飽和磁束密度ナノ結晶粉末の開発
53 [11] ナノ・マイクロマテリアル	山田 晴悟	大阪大学大学院	Ag/Cu複合焼結層に及ぼす熱時効の影響
54 [11] ナノ・マイクロマテリアル	川端 玲	大阪大学	酸化銀分解反応に基づく金属-シリコン基板間の低温接合プロセスの開発
55 [11] ナノ・マイクロマテリアル	熊谷圭祐	株式会社日本スペリア社R&Dセンター研究開発課	焼結Agナノ粒子を用いたNi接合の検討
56 [11] ナノ・マイクロマテリアル	綿谷 一駿	大阪大学 接合科学研究所 加工プロセス学分野	Cu-Zn合金の腐食を利用したCu微細構造による接合プロセスの検討
57 [11] ナノ・マイクロマテリアル	高田 侑希	大阪大学 工学研究科 マテリアル生産科学専攻	青色レーザー照射支援による銅ナノ粒子低温焼結接合
58 [12] 実装基板	加藤 義尚	福岡大学	部品内蔵モジュールの開発
59 [12] 実装基板	飯長 裕	沖プリンテッドサーキット株式会社	6Gを見据えた時にプリント配線板に必要な物は？
60 [12] 実装基板	瀬戸 寛生	奥野製薬工業株式会社	Co触媒を利用したポイドフリー最終表面処理プロセスの接合信頼性評価
61 [13] マイクロ加工	Ouyang Zhiyong	Okayama university	ガラスの超短パルスレーザー溶接において自由電子密度が接合特性に及ぼす影響
62 [13] マイクロ加工	中山 耕作	群馬大学大学院理工学府理工学専攻	マルチマテリアル用Fe/Alレーザー溶接部のミクロ組織と機械的特性
63 [13] マイクロ加工	池庄 司 敬孝	近畿大学	レーザー粉末床溶融法造形過程の粉末床温度分布の変化
64 [13] マイクロ加工	浅間 晃司	三菱電機株式会社 生産技術センター 構造化技術推進部	近赤外線レーザーによるSiの非溶融レーザーアニールプロセスの検討
65 [14] 接合プロセス・接合特性1	中村 光希	大阪大学大学院	電解析法による銅の低温接合
66 [14] 接合プロセス・接合特性1	篠原 勇人	群馬大学	ギ酸塩被膜付与Znシートを用いたAl合金の溶体化処理温度での接合
67 [14] 接合プロセス・接合特性1	植竹 亮太	北海道科学大学工学研究科機械工学専攻	溶融亜鉛めっき銅板とアルミニウム板材の摩擦圧接点接合
68 [14] 接合プロセス・接合特性1	熊本 光希	群馬大学大学院理工学府理工学専攻	A6061/亜鉛めっき銅板摩擦接点接合部の疲労特性
69 [14] 接合プロセス・接合特性1	Liu Shubin	群馬大学大学院理工学府理工学専攻	電解めっきを用いたNiろう薄膜の創製
70 [15] 接合プロセス・接合特性2	駒井 芹哉	国立大学法人 茨城大学	超音波接合されたCu複線ワイヤの熱サイクル試験による微細組織変化
71 [15] 接合プロセス・接合特性2	濱田 雅和	三菱電機株式会社	ウェッジボンド中の接合界面の温度が接合強度に及ぼす影響の考察
72 [15] 接合プロセス・接合特性2	加藤 真之	東京工業大学	梁高さをそろえた側面接触型斜め梁集合体の試作
73 [15] 接合プロセス・接合特性2	飯岡 諒	群馬大学理工学府知能機械創生部門	セルロースナノファイバー含有ニッケル複合めっき成膜条件の基礎研究
74 [15] 接合プロセス・接合特性2	屋山峻太	大阪大学 工学研究科 マテリアル生産科学専攻	ポーラスインサート材と低融点金属を用いた銅の液相浸透接合
75 [16] ソルダリング1	武石 正敬	株式会社ケーヒン	高密度実装におけるはんだ印刷のロバスト性向上
76 [16] ソルダリング1	平田 侑希	大阪大学 工学研究科	Sn-Bi-Zn-In合金を用いた接合部の特性評価
77 [16] ソルダリング1	岡直正	千住金属工業株式会社 開発技術部 ハンダテクニカルセンター	200℃以下で実装可能なSn-In-Ag-Bi系新規組成はんだの諸特性、および信頼性
78 [16] ソルダリング1	山中 佑太	群馬大学大学院理工学府理工学専攻	パワー半導体用Sn-Sb-Ag系はんだ接合部のパワーサイクル損傷挙動
79 [16] ソルダリング1	山内 啓	群馬工業高等専門学校 機械工学科	Sn-Bi-Sb合金の超塑性変形
80 [17] ソルダリング2	山本 瑞貴	群馬大学大学院理工学府理工学専攻	Sn-Sb-Ag系高温鉛フリーはんだのミクロ組織および疲労特性に及ぼす添加元素の影響
81 [17] ソルダリング2	泉水 崇彰	TDK株式会社	はんだ付け性試験の前処理が及ぼす影響
82 [17] ソルダリング2	濱田真行	大阪産業技術研究所 金属材料研究部	スズの高温引張特性に及ぼすガリウム添加の影響
83 [17] ソルダリング2	金下 征司	大阪大学接合科学研究所西川研究室	青色半導体レーザーを用いたレーザーはんだ付継手の界面評価
84 [18] 解析・シミュレーション	高原 渉	大阪大学	溶融銅の表面活性元素としての第16族元素の電子状態
85 [18] 解析・シミュレーション	原 英利	芝浦工業大学大学院 理工学研究科 材料工学専攻	球状シリカフィラー充填エポキシ樹脂の疲労き裂進展駆動力におよぼすフィラー粒径および配置の影響
86 [18] 解析・シミュレーション	佐藤雄河	芝浦工業大学大学院 理工学研究科 材料工学専攻	UV硬化接着剤の硬化過程における精密部品の位置ずれ解析
87 [18] 解析・シミュレーション	嶋場伸啓	(株)東レリサーチセンター 材料物性研究部	デジタル画像相関法を用いた冷却・昇温過程の熱ひずみ分布解析